

Wärmeleitprodukte

Thermipad® TP 22828

Wärmeleitpad

Aufbau: Thermipad® TP 22828 hat ein Siloxangehalt mit niedrigem Molekulargewicht. Dadurch ist es weniger wahrscheinlich, dass es zu Kontaktfehlern kommt.

Eigenschaften: Thermipad® TP 22826 hat eine hervorragende Wärmeleitfähigkeit und Flexibilität, schnelle Wärmeableitung und Wärmeübertragung auf Teile. Thermipad® TP 22828 ist ein elastischer, optimal anformbarer und spannungsarmer Gap Filler.

Anwendungen: Thermipad® TP 22828 wird z.B. für die thermische Anbindung von elektronischen Bauelementen, Halbleitern, IC's, Transistoren und Wärmeverteilern zu Kühlkörpern verwendet.

Standardfarbe: Thermipad® TP 22828 wird in der Farbe Schwarz geliefert.

Lieferformen: Thermipad® TP 22828 wird in Form von Bogenware 400 x 200 mm zur Verfügung gestellt. Zuschnitte und Formen nach Kundenspezifikation möglich.

Lagerbedingungen: Thermipad® TP 22828 sollte in trockenen Räumen bei Raumtemperatur und in der Originalverpackung gelagert werden.

Dr. Dietrich Müller GmbH

Thermipad® TP 22828

Eigenschaften	Methode	Einheit	Wert
Gesamtdicke	-	mm	0,5 – 2,0
Wärmeleitfähigkeit	ASTM-D5470	W/mK	10
Härte	ASKER C	-	< 65
Temperaturbereich	-	°C	- 40 bis + 150

Markeninformation: Thermipad® ist eine eingetragene Marke der Firma Dr. Dietrich Müller GmbH, Deutschland.

Zur Beachtung: Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Je nach Einzelfall empfehlen wir Rücksprache mit uns. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.